（上接B130版）

3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（三）风险防控措施

1、遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

2、公司已制定严格的《套期保值业务管理制度》，对整个套期保值的操作原则、风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

5、严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，为提高应对材料价格及汇率波动风险的能力，以降低原材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司经营稳健性，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司基于成本效益考量，为降低会计处理的复杂性与成本，对开展的套期保值业务将采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行简化处理，不适用《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展套期保值业务旨在降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，以及防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性。公司已针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展套期保值业务的事项履行了必要的审批程序，决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-006

芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或者"芯联集成"）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票169,200.00万股（超额配售选择权行使前），本次发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）25,471.45万元后，实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。本次发行募集资金已于2023年5月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号）。

2023年6月8日，保荐人国泰海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用（不含增值税）3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构（主承销商）已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399号）。

全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年科创板首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年5月5日 2023年6月9日（超额配售部分）
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,107,160.20
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	28,818.50
二、募集资金净额	1,078,341.70
减：	
以前年度已使用金额	914,306.59
本年度使用金额	117,868.42
暂时补流金额	0
现金管理金额	57,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.54
加：	
募集资金利息收入	12,043.43
三、报告期期末募集资金余额	709.58

注：公司以自有资金支付了部分原计划以募集资金支付的发行费用，合计270.85万元，公司已将上述270.85万元永久补充流动资金。具体内容详见2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年4月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴分行、兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年6月公司就合首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金（针对超额配售）专户存储三方监管协议》，同月公司与子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联先锋"）、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月，因募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项，将此前开立的募集资金账户注销，并于同月与芯联先锋、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行、交通银行股份有限公司绍兴分行、中信银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
芯联集成	招商银行股份有限公司绍兴分行	575903998610666	–	已注销
芯联集成	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000309403	–	已注销
芯联集成	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100158340	–	已注销
芯联集成	兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100165889	–	已注销
芯联先锋	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100159778	–	已注销
芯联先锋	招商银行股份有限公司绍兴分行	575904790310018	42.11	使用中
芯联先锋	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000368118	461.71	使用中
芯联先锋	中信银行股份有限公司绍兴分行	8110801012802844254	205.76	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
200,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）	2024年10月25日	2025年10月24日	2024年10月25日
68,300.00	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）	2025年10月24日	2026年10月23日	2025年10月24日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
芯联	交通银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	保本浮动收益型	22,000.00	2025-11-3	2026-1-28	–	22,000.00	0.9%/1.65%/1.85%	–
芯联	中信银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2025-11-8	2026-2-6	–	5,500.00	1%-1.71%	–
芯联	中信银行股份有限公司绍兴分行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2025-11-26	2026-2-28	–	30,000.00	1%-1.71%	–

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内募集资金投资项目不存在变更情况。公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》。此议案已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意调减"二期晶圆制造项目"拟使用募集资金投资的金额27.90亿元，并将该等调减金额通过向公司控股子公司芯联先锋增资的方式用于新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"。公司将充分有效发挥募集资金作用，满足12英寸硅基芯片的生产需求，进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，实现国内12英寸车载功率半导体芯片的工艺自主化和大规模制造产业化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

芯联集成《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了芯联集成2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

本年度投入募集资金总额	117,868.42
已累计投入募集资金总额	1,025,006.85
变更用途的募集资金总额	500,000.00
变更用途的募集资金总额比例	46.37%

承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二期晶圆制造项目	生产建设	是	666,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	100.00	2023年6月30日	不适用	不适用	否
中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	生产建设	是	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	100.00	2023年9月30日	不适用	不适用	否
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	生产建设	是	0.00	279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	-53,334.85	80.88	2027年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	412,341.70	412,341.70	412,341.70	0.00	412,341.70	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			1,078,341.70	1,078,341.70	1,078,341.70	117,868.42	1,025,006.85	-53,334.85	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"。												

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括："生产建设"、"研发项目"、"运营管理"、"投资并购"、"补流"、"还贷"、"回购公司股份"、"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	二期晶圆制造项目	生产建设	芯联先锋	浙江绍兴	279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	80.88	2027年12月31日	不适用	不适用	否	2024年1月9日	2024年1月26日
合计					279,000.00	279,000.00	117,868.42	225,665.15	–	–			–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"来满足12英寸硅基芯片的生产需求。公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》（2024-001）。此事项已经2024年1月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，决议内容详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-007）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-013

芯联集成电路制造股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计61.80万股。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年4月13日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2024年4月15日至2024年4月24日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030）。

（四）2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-035）。

（五）2024年6月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2025年5月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，并对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（八）2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，并对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划》《考核管理办法》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：

鉴于公司《激励计划》预留授予的激励对象中23人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计61.80万股限制性股票不得归属并按作废处理。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次作废限制性股票的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-014

芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次第二类限制性股票拟归属数量：1,114.90万股

● 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和2023年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

1、预留授予日：2025年4月22日。

2、预留授予数量：2,291.60万股，占目前公司股本总额的0.27%。

3、预留授予人数：354人。

4、预留授予价格：2.56元/股。

5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日且不得在下列期间内：

①公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本激励计划有效期内如果《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若预留部分在2024年三季报披露前授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排与首次授予一致。

若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工（共计763人）			9,166.40	80%	1.30%
预留部分			2,291.60	20%	0.33%
合计			11,458.00	100%	1.63%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2、本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

5、自2026年4月17日起单伟中先生不再纳入核心技术人员认定范围。

（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年4月15日至2024年4月24日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-030）。

3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-035）。

4、2024年6月4日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年5月19日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

7、2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理，同时对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

（三）限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2024年6月4日	2.56元/股	9,166.40万股	763	2,291.60万股
预留授予	2025年4月22日	2.56元/股	2,291.60万股	354	0

（四）本激励计划的归属情况

归属期次	归属日期	授予价格	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量
首次授予第一个归属期	2025年6月4日	2.56元/股	3,661.76万股	760人	7,784.24万股

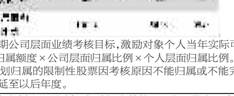
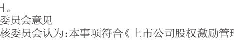
二、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

（一）本激励计划预留授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定，预留授予部分第一个归属期为自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。预留授予日为2025年4月22日，本激励计划中预留授予的限制性股票于2026年4月22日进入第一个归属期。

（二）关于本激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年年度股东大会的授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

<table>
<tr><th>归属条件</th><th>达成情况</th></tr>
<tr><td>1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。</td><td>公司未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。</td><td>除已作废限制性股票对应的激励对象外，预留授予的其他激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>3、激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，应满足12个月以上的任职期限。</td><td>除已作废限制性股票对应的激励对象外，预留授予的其他激励对象符合归属任职期限要求。</td></tr>
<tr><td>4、满足公司层面业绩考核要求
本激励计划预留授予部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2021-2023年营业收入均值为业绩基数，对每个归属期定比业绩基数的累计营业收入增长率进行考核，根据上述指标完成情况确定公司层面归属比例，预留授予部分的第一个归属期考核年度为2025年，具体考核指标为：
 
注：上述"营业收入"以经审计的营业收入为计算依据，下同。</td><td>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（天职业字[2025]第13528号）及2025年年度报告出具的审计报告（天职业字[2026]第19796号）：公司2024-2025年累计营业收入为146.89亿元，相比2021-2023年营业收入均值的增长率为268.61%，公司层面归属比例达100%。</td></tr>
<tr><td>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核根据公司现行的相关规定组织实施，届时根据以下考核评级表中对应的考核得分确定激励对象个人层面归属比例：
 
如果公司满足当期公司层面业绩考核目标，激励对象个人当年实际可归属额度=个人当年计划可归属额度×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。</td><td>本激励计划除23名激励对象因个人原因已离职外，预留授予的其余331名激励对象绩效考核得分为5、4或3，个人层面归属比例为100%。</td></tr>
</table>

综上所述，董事会认为《激励计划》预留授予部分设定的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的331名激励对象办理归属相关事宜。

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

（三）董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的331名激励对象办理归属1,114.90万股限制性股票的相关事宜。

三、2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的归属情况

（一）预留授予日：2025年4月22日。

（二）达成归属条件的限制性股票数量：1,114.90万股。

（三）达成归属条件的激励对象人数：331人。

（四）授予价格：2.56元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股。

（六）本次达成归属条件的激励对象名单：

职务	获授的限制性股票数量（万股）	达成归属条件的限制性股票数量（万股）	达成归属条件的限制性股票数量占已获授予的限制性股票总量的比例
中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他员工（331人）	2,229.80	1,114.90	50%
合计	2,229.80	1,114.90	50%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的331名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，预留授予部分激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属激励对象名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本激励计划无董事、高级管理人员参与。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，本次归属及本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；公司本次作废限制性股票的原因和数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-017

芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，同时对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行转回。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司本次计提信用减值损失1,389.84万元，转回信用减值损失0.59万元；计提资产减值损失97,929.04万元，转销资产减值损失91,893.72万元。计提及转回/转销各项资产减值准备合计将减少公司2025年度利润总额7,424.57万元。具体情况如下所示：

单位：万元

序号	项目	计提金额	本期减少金额		备注
			转回	转销	
1	信用减值损失	1,389.84	0.59	–	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、预付款坏账
2	资产减值损失	97,929.04		91,893.72	存货跌价损失、固定资产减值损失
合计		99,318.88	0.59	91,893.72	/

二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、预付款项进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额1,389.84万元，转回信用减值损失0.59万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，公司评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。2025年度计提存货跌价损失金额92,547.59万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值的产品以前计提减值的影响因素已经消失或实现对外出售，2025年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销91,893.72万元。本报告期计提及转销存货跌价损失将影响公司2025年度利润总额653.87万元。

资产负债表日，公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试并估计其可收回金额，当可收回金额低于其账面价值时，需按差额计提资产减值损失。依据《企业会计准则第8号——资产减值》，可收回金额应按公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者中的较高者。2025年度计提固定资产减值损失5,381.45万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度利润总额7,424.57万元。公司本次计提、转回/转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况。

本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-009

芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允，结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月17日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2026年4月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

本次日常关联交易预计事项需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁及相关配套服务	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	46.24	2.60	23.12	46.24	2.60	
向关联人购买资产	盛吉盛半导体科技股份有限公司	2,043.00	0.74	–	5,496.86	1.99	实际业务发展需要
向关联方采购商品/接受劳务	上海芯港联测半导体有限责任公司	23,416.00	4.42	4,272.14	1,044.96	0.20	实际业务发展需要
	盛吉盛半导体科技股份有限公司	430.00	0.08	184.72	193.75	0.04	
向关联方出售商品/提供劳务	上海芯港联测半导体有限责任公司	21,288.00	2.60	4,773.72	1,494.18	0.18	实际业务发展需要
向关联方转让资产	上海芯港联测半导体有限责任公司	40,000.00	123.61	2,936.85	–	–	实际业务发展需要
为关联方提供租赁服务	上海芯港联测半导体有限责任公司	896.00	162.22	214.05	68.87	12.47	实际业务发展需要
合计		88,119.24	/	12,404.60	8,344.86	/	/

注：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁及相关配套服务	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	46.24	46.24	
向关联人购买资产	盛吉盛半导体科技股份有限公司	2,561.00	5,496.86	实际业务发展需要
向关联方采购商品/接受劳务	上海芯港联测半导体有限责任公司	6,144.65	1,044.96	实际业务开展时间调整
	盛吉盛半导体科技股份有限公司	–	193.75	实际业务发展需要
向关联方出售商品/提供劳务	公司董事、高级管理人员（丁国兴、赵奇、刘煊杰、王韦、肖方、张霞、严飞、张毅）	3,111.86	3,111.86	
	上海芯港联测半导体有限责任公司	6,025.99	1,494.18	实际业务开展时间调整
为关联方提供租赁服务	上海芯港联测半导体有限责任公司	251.43	68.87	实际业务开展时间调整
合计		18,141.17	11,456.72	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司

公司名称	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
成立时间	2005-03-09
统一社会信用代码	913306007719222220
注册资本	50000万人民币
法定代表人	寿景兴
公司性质	有限责任公司（国有控股）
住所	浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2号楼520-3室
主要股东/股权结构	绍兴高新技术产业开发区控股集团有限公司95.9882%；绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司4.0118%
经营范围	一般项目：城市基础设施投资开发、营运和管理养护；建设工程项目代建（涉及许可或资质的凭有效许可或资质经营）；土地开发投资；土地开发；停车服务；房屋租赁；批发零售：建筑材料、物业管理；场地租赁；保洁服务；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据	2025前三季度总资产799.95亿元、净资产301.64亿元、营业收入11.22亿元、净利润1.48亿元。

2、盛吉盛半导体科技股份有限公司

公司名称	盛吉盛半导体科技股份有限公司
成立时间	2018-03-22
统一社会信用代码	91330200MA2AHN2244
注册资本	88,496.9314万人民币
法定代表人	项习飞
公司性质	股份有限公司（外商投资、未上市）
住所	浙江省宁波市云龙镇石桥村
主要股东/股权结构	天津吉盛管理咨询合伙企业（有限合伙）10.0878%；中芯国际控股有限公司7.8893%；宁波芯空间盛芯创业投资合伙企业（有限合伙）7.0874%；TRIPLECORES KOREA CO., LTD. 6.5744%；上海赤芯管理咨询合伙企业（有限合伙）6.4665%；上海新阳半导体材料股份有限公司5.6039%等
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；销售代理；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据	基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。

3、上海芯港联测半导体有限责任公司

公司名称	上海芯港联测半导体有限责任公司
成立时间	2025-09-26
统一社会信用代码	91310000MAEWM7R45L
注册资本	40000万人民币
法定代表人	任鹏
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道1号
主要股东/股权结构	芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司50%；上海质芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）50%
经营范围	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据	芯港联测成立时间不足一年，且无实际控制人，故无最近一年主要财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	越城基金的有限合伙人之一，并持有越城基金46.0993%财产份额，间接持有公司5%以上股份
2	盛吉盛半导体科技股份有限公司	徐慧勇担任董事的企业，且徐慧勇实际控制持有公司5%以上股份的股东滨海芯兴的GP宁波北仑
3	上海芯港联测半导体有限责任公司	根据实质重于形式原则认定的其他关联方

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格或合理的收费标准确定；公司及子公司将在交易前与各关联方签署具体的协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会、股东会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意的意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-008

芯联集成电路制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988年12月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域		
首席合伙人	邱靖之	上年度末合伙人数量	90
上年末执业人员数量	注册会计师		1097
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		399
2024年业务收入（经审计）	业务收入总额	25.01亿元	
	审计业务收入	19.38亿元	
	证券业务收入	9.12亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	154家	
	审计收费总额	2.30亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		88家

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	周春阳	2005	2006	2011	2025	近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告4家
签字注册会计师	方继伟	2023	2021	2023	2026	近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家
项目质量控制复核人	胡建军	1998	2001	2000	2025	近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告4家，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年审计费用为人民币100万元，其中财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计费用的定价原则不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-010

芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度银行授信额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司2026年度拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

● 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司在2026年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

以上授权的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-012

芯联集成电路制造股份有限公司关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）基于长期战略发展规划，结合研发人员工作内容变动与公司研发工作实际推进需求，对核心技术人员构成进行调整：原核心技术人员单伟中先生不再纳入核心技术人员认定范围，调整后将在公司相应适配岗位任职。

● 本次核心技术人员的调整已完成相关合规审查，不涉及专利权属纠纷或潜在争议，公司核心技术及知识产权权属保持完整，不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

公司基于长期战略发展规划，综合考量研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作实际推进需求等多重因素，经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员单伟中先生因工作分工调整及岗位职能变化，不再被认定为核心技术人员，仍在公司担任相应适配岗位，履行岗位职责。

原核心技术人员的具体情况如下：

1、原核心技术人员简介

单伟中，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年至2018年，曾任中芯国际薄膜工艺资深经理、工艺整合资深经理。2018年至今，任公司执行总监。

截至本公告披露日，单伟中先生直接持有公司股份240,000股，持股比例为0.0029%，通过员工持股平台间接持有公司股份8,015,040股。单伟中先生不再被认定为核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、知识产权情况

单伟中先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与单伟中先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。单伟中先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现单伟中先生有违反相关协议的情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，已构建起体系化、科学化的研发管理体系，培养了一支兼具专业素养、奋斗精神与创新能力的研发团队。团队内部分工明确、协作高效，核心技术研发以集体攻坚为核心模式，不存在对单一核心技术人员的依赖。

截至2023年末、2024年末、2025年末，公司研发人员数量分别为662人、943人、1,226人，占员工总人数的比例分别为15%、19%、21%，研发人员数量呈增长趋势。研发团队结构稳定、专业配置均衡。本次调整后，公司核心技术人员团队仍保持充足的技术储备与研发能力，现有研发团队及核心技术人员能够完全支撑公司未来核心技术的持续迭代与创新产品的研发推进。本次核心技术人员调整是公司根据战略发展与岗位适配性作出的举措，以确保研发团队的建设与公司的研发方向相匹配，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，公司技术研发与日常经营活动均正常有序开展。

截至本公告披露日，公司核心技术人员变动情况如下表所示：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	赵奇、刘煊杰、肖方、单伟中
本次变动后	赵奇、刘煊杰、肖方

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司技术研发工作稳步推进，日常经营秩序井然，研发团队结构完整，后备人才储备充足，现有研发力量能够充分保障核心技术的持续创新与产品的迭代升级。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设，后续公司将采取以下措施：

1、加大专业技术人才引进力度，聚焦核心技术领域，精准吸纳行业内高端人才与优秀青年人才，持续优化研发团队结构；

2、完善内部人才培养体系，搭建技术培训、项目实践、职业晋升相结合的成长通道，加速后备技术人才培育；

3、优化研发人员考核与激励机制，将研发成果、技术贡献与薪酬回报、股权激励等深度绑定，充分激发研发人员的创新积极性与主动性；

4、持续加强知识产权保护体系建设，完善专利申请、维护、运用等全流程管理，确保公司核心技术与知识产权的安全性、完整性。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2026-015

芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

经审议，2026年关联交易预计总额为88,119.24万元。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告》。

13、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意2026年度公司及公司子公司拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。授权有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度银行授信额度预计的公告》。

14、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案中《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

15、审议通过了《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第二届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

本议案中2026年度高级管理人员薪酬方案将在2025年年度股东会中进行说明

17、审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

18、审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》

经审议，同意公司及子公司与银行等金融机构开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务，拟开展的商品期货套期保值交易品种涉及黄金、白银、钯、铂、铜等现有主营现货对应的期货品种；外汇衍生品业务品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。拟进行商品期货套期保值业务及衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告》。

19、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74元，公司实收股本8,382,687,172元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予的激励对象中23人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计61.80万股限制性股票不得归属并按作废处理。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，经公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为1,114.90万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的331名激励对象办理归属相关事宜。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司召开2025年年度股东会的通知》。

23、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日